

**取扱い説明書**  
**INSTRUCTION MANUAL**

SERIES 6401  
72 PIN Right-Angle SMT  
S.O.DIMM CONNECTOR

|    |          |         |           |       |          |  |
|----|----------|---------|-----------|-------|----------|--|
|    |          |         |           |       |          | <b>ENGINEERING<br/>DEPT.,<br/>KYOCERA ELCO<br/>Corporation</b> |
| A  | DCN-1114 | 9/21/06 |           |       |          |  |
| O  | EDN-889  | 11/8/02 | M.Yoshida | /     | T.Sasaki |  |
| NO | EDN/DCN  | DATE    | PREPARED  | CHECK | APPROVED |  |

目 次  
CONTENTS

|  |   |
|--|---|
| 1. 概要 SCOPE -----                                | 2 |
| 2. 製品型番 PART No. SYSTEM -----                    | 2 |
| 3. 各部の名称 NAME OF EACH PART -----                 | 2 |
| 4. DIMM 基板挿入方法 METHOD OF INSERTION -----         | 3 |
| 5. 取り扱い上の注意 HANDLING PRECAUTIONS -----           | 4 |
| 6. メモリー基板について CAUTIONS ON THE MEMORY BOARD ----- | 5 |

1. 適用範囲 SCOPE

1. 概要 SCOPE

本製品6401 シリーズコネクタにおいて、メモリー基板の嵌合・離脱時に於ける注意点について掲載します。

This manual shows notes in handing Series 6401 when the memory board shall be inserted and separated correctly.

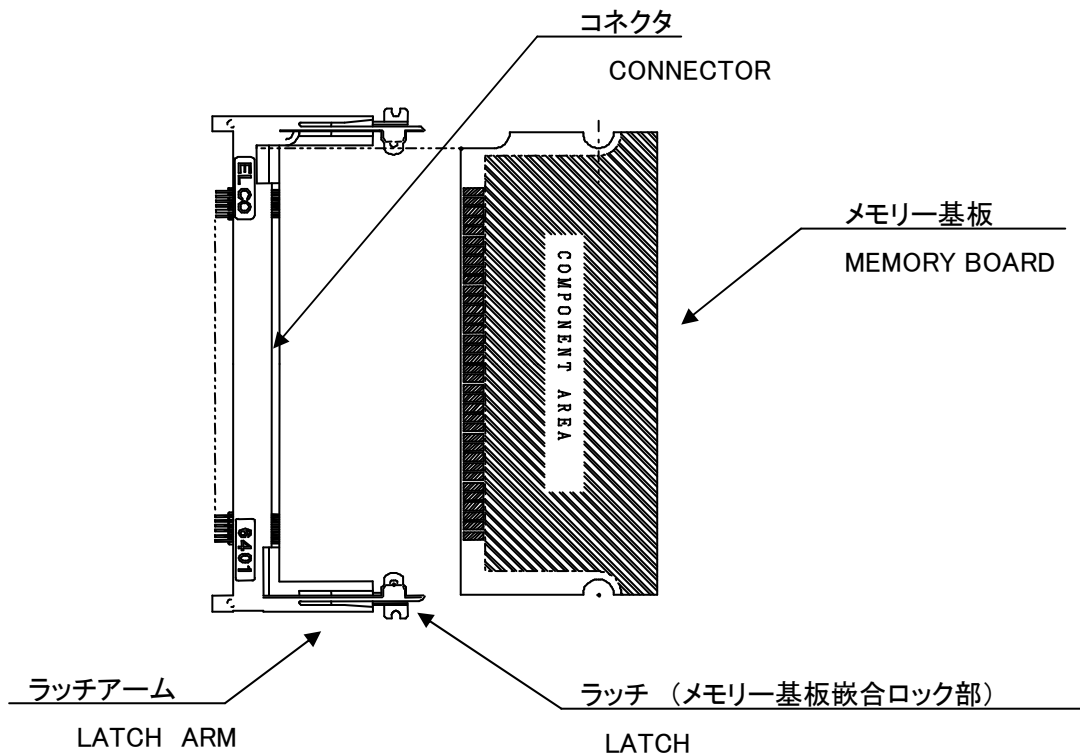
2. 製品型番 PARTS NO. SYSTEM

20 6401 072 \* \* \* 856

\*\*\*: バリエーション Variation

3. 各部の名称 NAME OF EACH PART

SERIES 6401 72P S.O.DIMM CONNECTOR



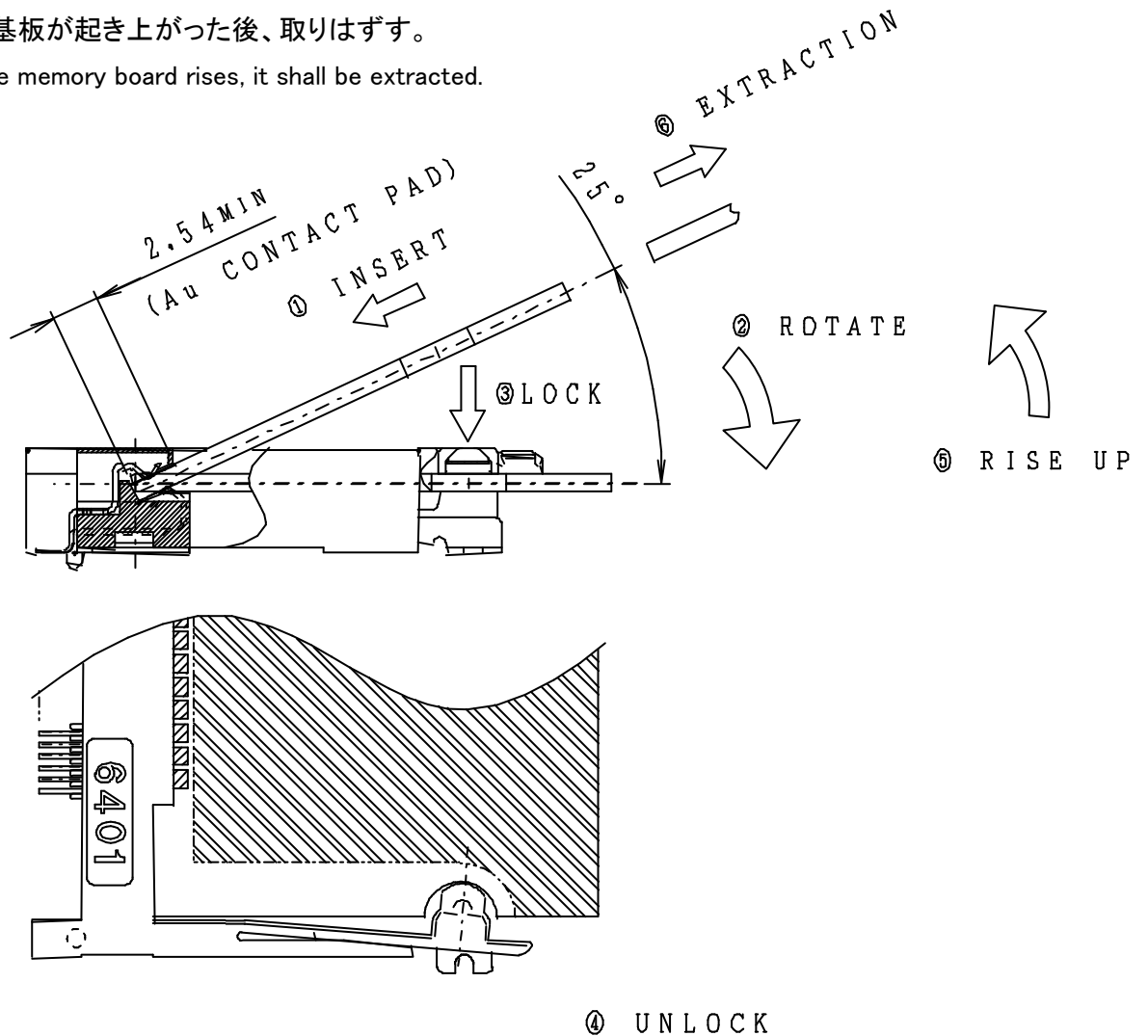
#### 4. DIMM 基板挿入方法

##### < 嵌合方法 Method of insertion >

- ① メモリー基板を完全に奥まで挿入する。  
The memory board shall be inserted completely.
- ② 回転させる。  
It shall be rotated.
- ③ 下方向へ押し込み、両側のラッチにロックさせる。  
It shall be pushed into the latch on the both side from upward.

##### < 離脱方法 Method of separation >

- ④ 両側のラッチのロックを解除させる。  
The latch on both side shall be unlocked.
- ⑤ メモリー基板が起き上がった後、取りはずす。  
After the memory board rises, it shall be extracted.

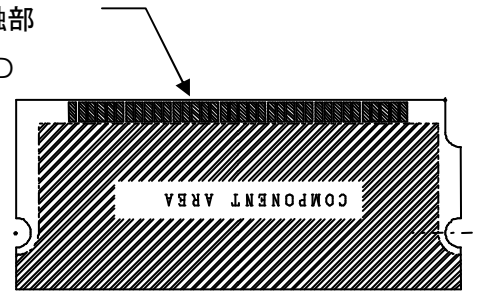


## 5. 取り扱い上の注意点 Handling precautions

5-1. メモリー基板を挿入する前に、メモリー基板接触部に実装時のフラックス等のゴミが付着していないことを確認ください。

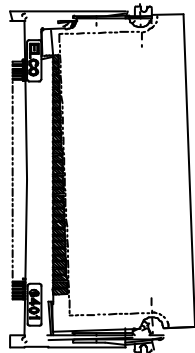
Before inserting the memory board, make sure that there is no dirt, such as flux stuck on the contact pad of the memory board in the mounting process.

メモリー基板接触部  
CONTACT PAD



5-2. メモリー基板を挿入の際、コネクタに対してメモリー基板を斜めに挿入した場合には、基板がコネクタにロックされません。無理に押し込むとラッチが破損する可能性があります。

When inserting the memory board, the board is not locked in the connector in case the memory board is inserted on the skew against the connector. The latch may be broken by being pushed forcibly.

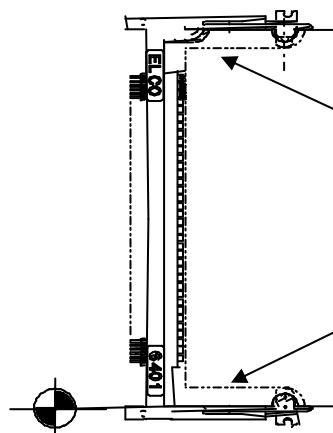


メモリー基板の斜め嵌合をしないで下さい。  
両端が奥まで挿入されてからラッチ部に基板を押し込んでください。

Do not insert the memory board on the skew. Make sure to place the both edges in the back of the connector, then push the board into the latch area to lock.

5-3. メモリー基板挿入時に極端にキーイング側に寄せながら嵌合しないで下さい。無理に嵌合した場合アームが破損する恐れがあり、基板はコネクタにロックされません。反キーイング側を目安に基板を挿入、嵌合操作を行ってください。

When insert in the memory board, do not insert the board with holding it toward the keying side. If inserting the board forcibly, the arm may be broken and the board is not locked in the connector. Insert the board with reference to the opposite side of the keying side and then lock it.



キーイング側 Keying side

反キーイング側を基準に挿入、嵌合してください。  
Insert with reference to the opposite side of the keying side and lock it.

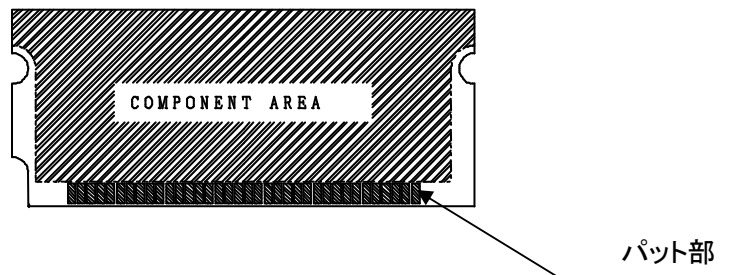
## 6. メモリー基板について CAUTIONS ON THE MEMORY BOARD

- 6-1.メモリー側の基板端面処理について When using a stamped-out PCB as a memory board  
打ち抜きの基板の場合、ガラス繊維の飛散などにより再現しない接触不具合が懸念されます。  
端面打ち抜きの基板はなるべく使用せず、やむなく使用する際は同通の確認を行い、更にメモリー  
基板が動かないように完全固定を行ってください。  
固定の方法についてはねじ止めを推奨しますが、固定する際にコネクタとメモリー基板に負荷を  
与えないようにご注意ください。

If a stamped-out PCB is used as a memory board, splashed glass fiber will cause a contacting failure that is not reproducible. It is preferable, therefore, not to use a stamped-out PCB. In case of using it unavoidably, check the electrical continuity and fix the memory card completely.  
It is preferable to use screws to fix the board. Pay attention not to apply extra stress on the connector and the board when fixing them.

- 6-2.接触部の Au めっき仕様について Plating treatment on conductors  
JEDEC 規格準拠により、Au0.76  $\mu$ m又は封孔処理(ルブリカント)を使用し同等の性能の表面処理(Au めっき)を施したものを推奨致します。  
コネクタ側は Au0.1  $\mu$ mMIN.に封孔処理を施しています。  
Au0.03  $\mu$ mなどの場合、耐環境及び下地酸化物の検出が懸念されます。

In accordance with JEDEC standards, it is recommended for conductors of the memory board to be plated with 0.76  $\mu$ m of Au or applied sealing treatment (lubricant) to obtain the equivalent performance of the Au-plating.  
0.1  $\mu$ m of Au at minimum of sealing treatment applied on contacts.  
With 0.03  $\mu$ m of Au-plating or such, there is concern that resistance to environment will deteriorate or base oxide will surface.



6-3.フラックスの飛散について Splash of flux

パッド部に実装時のフラックスが飛散しないようご注意ください。

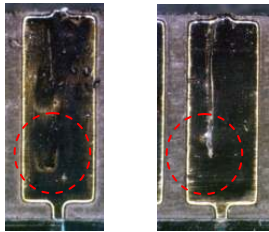
コネクタ側でも軽微なフラックスなどを掻き分ける形状(R 接触構造)を採用していますが、万が一にも掻き分けた異物に乗り上げる可能性などもある為、基板側での接触面の管理をお願い致します。

Pay attention not to splash the flux onto the contact pads in the soldering process. Although R-shaped-contact structure that enables to thread its way through slight flux is adopted on the connector, there is a slight possibility that the contact could go up on the flux. Consideration for avoiding such failure shall be required.

参考 摺動痕比較 (面接触とR 接触構造の比較)

Comparing the contacting marks between face-contact and R-shaped-contact

↓ 嵌合方向 Inserting direction



面接触  
Face-contact

R接触  
R-shaved  
contact

DIMM 基板パッドにマジックインクにて着色、嵌合させ、比較を行いました。  
結果、面接触に比べ R 接触にすることで集中荷重が得られることから異物除去の効果が期待できます。

The contact pads on the board are colored, and inserted to the connector for comparison.

In result, it is determined that R-shaped contact enables to thread its way through more effectively by the focused contact due to the shape.